

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **被担保人名称：**杭州士兰集昕微电子有限公司
- **本次担保金额：**公司本次拟为控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司未来 12 个月内提供不超过 8 亿元的连带责任担保。
- **本次担保无反担保**
- **对外担保累计金额：**

截止 2017 年 3 月 31 日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 4.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

- **本公司不存在逾期对外担保**

一、担保情况概述

本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）为保证生产经营需要，拓宽融资渠道，拟向金融机构申请授信。本公司在未来 12 个月内拟为士兰集昕向金融机构申请授信提供总额不超过 8 亿元人民币的连带责任担保。

本公司于 2017 年 6 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，同时提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：杭州士兰集昕微电子有限公司
- 2、成立时间：2015 年 11 月 4 日
- 3、注册地址：杭州经济技术开发区 10 号大街（东）308 号 13 幢
- 4、注册资本：82,000 万元
- 5、法定代表人：陈向东
- 6、经营范围：生产、销售：8 英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）。
- 7、股东情况：本公司控股子公司杭州集华投资有限公司持有 48.78%，本公

司直接持有士兰集昕 2.2%股权，本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司持有 0.24%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有 48.78%。

8、截止 2016 年 12 月 31 日，士兰集昕经审计的总资产为 81,312.82 万元，负债 204.53 万元，净资产 81,108.29 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，士兰集昕未经审计的总资产为 76,640.35 万元，负债-4,412.49 万元，净资产 81,052.84 万元。该公司处于建设期，尚无营业收入。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议，公司将根据士兰集昕的申请，按照资金需求予以安排。

四、董事会意见

2017 年 6 月 13 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司独立董事认为：

1、公司本次拟为控股子公司士兰集昕未来十二个月提供不超过 8 亿元的连带责任担保，是合理、必要的经营管理行为，有助于士兰集昕在合适的时间节点进一步扩充产能；

2、该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，尚待公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准；

3、士兰集昕为公司重要控股子公司，该担保事项有利于进一步夯实公司的生产经营基础，不存在损害公司及股东利益的情形；

4、同意公司在未来 12 个月内对士兰集昕提供不超过 8 亿元人民币的连带责任担保。

五、公司担保情况

截止 2017 年 3 月 31 日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 4.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于担保发表的独立意见。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日